

国外 集成电路

命名方法 手册

三

国外集成电路 命名方法手册

计算机工业管理局 谭家升
中国计算机技术服务公司 刘桂君 编译

《计算机应用通讯》编辑部

前 言

随着微电子技术的发展,在计算机的设计、制造中,广泛采用了各种类别、系列,品种繁多的集成电路,以达到提高可靠性和寿命、增强功能、减小体积、降低成本等目的。

近年来,为了加速我国的四化建设,不少单位引进了国外的计算机设备,在维修中需用国外集成电路;一些研究、生产单位在国产计算机的设计制造中,也采用了一些国外集成电路,因此,需要很好了解和研究国外集成电路的性能、使用及价格等。很多使用集成电路的用户反映,对国外集成电路如此繁杂的产品型号及其含义不甚清楚,因而经常有选用不当的情况。例如:本来塑料封装的电路即可满足要求,却选用了价格贵几倍的陶瓷封装电路,只需一般使用要求的电路却选用了价格贵若干倍的军品电路等等。这种大材小用,优材劣用,既不能充分发挥所选用电路的性能,经济上也造成浪费。为了帮助用户较为准确地了解和选用国外集成电路,我们编译了“国外集成电路产品型号命名方法介绍”。

国外不同的集成电路制造厂,对产品有各

自的型号命名方法，所使用的符号和数字都有特定的含义。从产品型号上可大致反映出该产品在制造(结构、工艺…)、性能、封装、使用等级等方面的基本特性和要求，有的产品型号中还含有制造厂家的代号。综观国外各集成电路制造厂家的产品型号，一般都由“前缀”、“器件”、“后缀”三部分组成。“前缀”部分常表示公司代号、功能分类、产品系列等，“器件”部分常表示芯片的结构、容量、类别等，“后缀”部分常表示封装形式、使用温度范围、筛选等级、功率、速度(存取时间)、分辨率、引线数等。本文编译了国外六十六个集成电路制造厂家的产品型号命名方法。因水平有限，难免有不当之处。欢迎批评指正。

编 译 者

1984 年 5 月

目 录

一、前 言

二、国外主要集成电路制造厂家的代码和名称

1. AMD-Advanced Micro Devices.
先进微型器件公司…………… (1)
2. AMI-American Micro- Systems Inc.
美国微系统公司…………… (3)
3. ANA-Analoge Devices Inc.
模拟器件公司…………… (5)
4. BUB-Burr-Brown Research Corp.
巴尔-布劳恩研究公司……… (6)
5. CHE-Cherry Semiconductor Corp.
凯勒半导体公司…………… (7)
6. CMS-Cybernetic Micro Systems.
控制微系统公司…………… (9)
7. DTL-Datel-Intersil Inc.
德特尔-英特西尔公司……… (10)
8. EAI- { NEC Electronics U.S.A Inc—
 { Electronic Arrays Division
 日本电气 (美国) 公司
 电子陈列部…………… (12)

9. EXR-Exar Integrated Systems Inc.
Exar 集成系统公司…… (13)
10. FSC-Fairchild Camera &
Instrument Corp.
仙童摄影机仪器公司…… (15)
11. FCAJ-Fujitsu Limited
富士通公司…… (17)
12. GIC-General Instrument Corp.
通用仪器公司…… (18)
13. GTE-GTE Microcircuits Div.
GTE公司微型电路部…… (23)
14. HAS-Harris Semiconductor
哈里斯半导体公司…… (25)
15. HITJ Hitachi Ltd.
日立公司…… (28)
16. HAC-Hughes Aircraft Co.
休斯飞机公司…… (29)
17. HBC-Hybrid Systems Corp.
混合系统公司…… (30)
18. DDC-ILC Data Devices Corp.
ILC 数据器件公司…… (32)
19. INMOS
INMOS 公司…… (35)

20. ITL-Intel Corp.
英特尔公司…………… (37)
21. IMI-International Microcircuits
国际微型电路公司…………… (40)
22. INL-Intersil Inc.
英特西尔公司…………… (42)
23. JAN NOMENCLATURE
JAN 诺曼克雷切公司…………… (49)
24. LAM-Lambda Semiconductor
LAMBDA 半导体公司…………… (52)
25. MASTER LOGIC
标准逻辑公司…………… (53)
26. MNC-Micro Networks Corp.
微型网络公司…………… (55)
27. MPS-Micro Power Systems.
微功率系统公司…………… (56)
28. MITC-Mitel Corp
密特尔公司…………… (57)
29. MITJ-Mitsubishi Electric Corp.
三菱电机股份公司…………… (58)
30. MMI-Monolithics Memories Inc.
单片存储器公司…………… (61)
31. MOS-Mostek Corp.
莫斯特克公司…………… (67)

32. MOTA-Motorola Semiconductor
Products Inc.
莫托洛拉半导体产品公司…… (68)
33. NSC-National Semiconductor
国家半导体公司…… (71)
34. NECJ-Nippon Electric Co. Ltd.
日本电气股份公司…… (80)
35. NECE- $\left\{ \begin{array}{l} \text{NEC Electronics U.S.A Inc.} \\ \text{Microcomputer Division} \end{array} \right.$
日本电气 (美国) 公司
微型计算机部…… (82)
36. NIT-Nitron Inc.
Nitron 公司 …… (83)
37. OEI-Optical Electronics Inc.
光电公司…… (85)
38. MATJ-Matsushita Electronics
Corp.
松下电器产业股份公司…… (86)
39. PLSB-Plessey Semiconductor
普莱赛半导体公司…… (87)
40. PMI-Preoision Monolithics Inc.
普勒欧依歇单片公司…… (89)
41. PRO ELECTRON
PRO电子公司…… (91)

42. RTN-Raytheon Company
雷声公司…………… (95)
43. RCA-RCA Corp.
美国无线电公司 …… (100)
44. RET-EG & G Reticon
EG & G Reticon公司 …… (102)
45. RKW-Rockwell International
Corp
洛克威尔国际公司 …… (105)
46. TSAJ-Tokyo Sanyo Electric
Co. Ltd
三洋电机股份公司 …… (107)
47. SEEQ
SeeQ 公司 …… (108)
48. SGAI-SGS-ATES Componenti
Elettronici
SGS-ATES公司元器件部… (110)
49. SIEG-Siemens Aktiengesellschaft
Semiconductor Div.
西门子公司 …… (111)
50. SIC-Signetcs Corp.
西格尼蒂克斯公司 …… (112)

51. SGL-Silicon General Inc.
硅通用公司 (116)
52. SIX-Siliconix Inc.
西里科尼克斯公司 (118)
53. SSS-Solid State Scientific Inc.
固态科学公司 (122)
54. SOD-Solitron Devices Inc.
索里切器件公司 (123)
55. SPR-Sprague Electric Co.
斯普勒格电气公司 (125)
56. SMC-Standard Microsystems
标准微 型系统公司 (128)
57. SYK-Synertek Inc.
西奈尔蒂克系统公司..... (130)
58. TPN-Teledyne-Philbrick
特里达依—费尔博瑞克公司..... (131)
59. TSC-Teledyne Semiconductor
特里达依半导体公司..... (132)
60. ALGG-Telefunken Electronic
GmbH
特里方克电子公司..... (133)
61. TII-Texas Instruments Inc.
德克萨斯仪器公司..... (134)
62. TOSJ-Toshiba Corp.
东芝电气股份公司..... (139)

63. TRW-TRW-LSI Products
TRW-大规模集成电路
产品公司 (140)
64. UNIVERSAL SEMI-
CONDUCTOR INC.
宇宙半导体公司 (142)
65. WDC-Western Digital Corp.
西方数字公司 (143)
66. ZIL-Zilog Microcomputers
泽洛格公司 (144)

附:

北京前门器件厂集成电路产品介绍



AMD-
ADVANCED
MICRO
DEVICES

AMD - Advanced Micro Devices 先进微型器件公司

举 例

“前缀” “器件” “后缀”

A M 25 S 05 D M

公司代号

功能分类

类型

器件数值

封装

温度范围

型号组成部分的符号和数字的意义:

功能分类

25 中规模集成电路,

- 26 计算机接口,
- 27 双极型存储器,
- 28 MOS(金属一氧化物一半导体)
- 29 双极型微处理器
- 90 MOS
- 91 MOS
- 92 MOS
- 94 MOS
- 95 MOS
- 79 电信

类 型:

- L 低功耗
- S 肖特基
- LS 低功耗肖特基
- 无标记 标准型

封 装:

- D 密封双列直插
- P 塑料封装
- F 扁平封装
- X 芯片
- L 无引线芯片载体

温度范围:

- C 商用
- M 军用

AMI

AMI-
AMERICAN
MICRO
SYSTEMS
Inc.

AMI - American Microsystems, Inc. 美国微系统公司

举 例

	“前缀”	“器件”	“后缀”
	S	68A00	P ₁
		5101L—1	C
系列		2559A	P
种类			
封装类型			

型号组成部分的符号和数字的意义:

系 列

S 标准型

封装类型

P 塑料封装

- D 陶瓷浸渍
C 陶瓷封装
L 无引线芯片载体

引线数/封装类型

- 8 塑料封装
14 塑料封装, 陶瓷封装
16 塑料封装, 陶瓷浸渍, 陶瓷封装
18 塑料封装, 陶瓷浸渍, 陶瓷封装
22 塑料封装, 陶瓷浸渍, 陶瓷封装
24 塑料封装, 陶瓷浸渍, 陶瓷封装
28 塑料封装, 陶瓷浸渍, 陶瓷封装
40 塑料封装, 陶瓷浸渍, 陶瓷封装
64 塑料封装, 陶瓷封装
20 引线 芯片载体
24 引线 芯片载体
24 引线 Slam芯片载体
28 引线 芯片载体
28 引线 Slam芯片载体
40 引线 芯片载体
44 引线 芯片载体
44 引线 Slam芯片载体
68 引线 芯片载体
84 引线 芯片载体



ANA-
ANALOG
DEVICES
Inc.

ANA - Analog Devices Inc.

模拟器件公司

举 例

“前缀” “器件” “后缀”

AD	7516	J	N
公司代号			
温度范围			
封装			

型号组成部分的符号和数字的意义:

公司代号

AD 模拟器件公司

温度范围

A, B, C 工业范围

J, K, L 商用范围

S, T, U 军用范围

封 装

D 陶瓷双列直插

F 陶瓷扁平封装

H TO-5型管壳

N 塑料双列直插



BUB-BURR-
BROWN

巴尔一布劳恩
研究公司

BUB - Burr Brown Research Corp.

举 例

“前缀”

“器件”

“后缀”

3532

A

M

Q

温度范围

封装

筛选等级